

ご確認日	ご確認印	承認	審査	作成

御 打 合 議 事 録 (第 4 回)				
御 納 先	高エネルギー加速器研究機構 殿 (KEK殿)			
請 負 者	(株)日立テクノロジーアンドサービス (日立TS)			
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式			
打 合 日 時	平成26年7月28日(月) 15:00~15:45			
打 合 場 所	KEK殿 1号館談話室1			
出席者	顧 客	菊池様、多和田様、飯田様		
	請負者	日立TS：小林、山下		
配布先	KEK殿×各1、日立TS×1、SPT×1			
議 題	本 文	担 当	期 限	
(主旨)	施工に係る諸事項の確認を行った。			
(資料)	日立TS ①グレーチング部のベースプレート案(図番：QMF5N_R1) ②グレーチング部のベースプレート案(図番：QMF2S_R1_2) ③グレーチング部のベースプレート案(図番：QMF2S(案2))			
(議事)	1 電磁石架台の下に敷く嵩上げ鉄板(資料無し) (1) 板厚：25mm以上の標準厚で可。 (2) 形状：1) B電磁石；ビームラインを跨ぐ2脚で1枚(2枚/台) 2) B電磁石以外；架台と同形状(1枚/台) ※ST電磁石分は四隅の角を落とさず矩形で可。 (3) 全面に錆止め塗料を塗ること(色指定は無し)。	日立TS		
	2 グレーチング部のベースプレート(資料①～③) (1) QMF5N分(排水溝部)：資料①で可。 (2) QMF2S分(Exp. J部)：資料③で可。 但し、上流側2本のアンカーボルト(部位「B」)の打ち込み深さは歩床コンクリートの厚さ(200mm)以下とすること。 (3) QMF5N分、QMF2S分共通 1) 床面とベースプレートとのガタはシムで調整すること。 2) プレート直下のグレーチングは切断し取り外すこと。	日立TS 日立TS 日立TS		
	3 その他 (1) 電磁石架台の床面への固定は寸切ボルトで可。 (2) 架台底面が無塗装の電磁石は錆び止め塗料を塗ること。 ※ニスが塗ってあるものはニスを除去した後、塗ること。 (3) B電磁石はアライメント摺動面にグリスが塗ってあるので、設置に際しては、これを除去すること。 (4) 電材支給品(圧着端子等)のリストを提出すること。	日立TS 日立TS 日立TS		
	以上			